

晶体硅钻孔硅片打孔

产品名称	晶体硅钻孔硅片打孔
公司名称	江阴德力激光设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江阴市金山路201号
联系电话	0510-86990113 13921360970

产品详情

描述：WT) 钻孔，在0.2晶片上钻0.2毫米的孔，速度为0.2s/hole，侧壁质量良好。加工线宽窄，品质高，热影响区域小；

德力激光专注于微米级的激光精密切割、钻孔、蚀刻、刻线、划片、材料去除、构造、雕刻和特殊材料的打标，主要应用于LED芯片制造，触摸屏，LCD，消费类电子，半导体，MEMS，照明，医疗等行业，以及科研、航天航空、军事等领域，涉及包括各种金属及合金、半导体、陶瓷、各种透明材质（玻璃、石英、蓝宝石等）、薄膜和聚合物等各种材料，公司已经做过1000多个基于以上材料的各种激光微加工试验和方案。

德力激光业务范畴包括前期的方案可行性研究和新制程开发服务、中期小规模试产和论证、后期的规模化量产业务外包等，凭借着强大的技术支持，丰富的工艺开发经验和先进的信息化管理，德力激光立志成为国内激光精密微加工和微制造的领跑者，为客户提供定制化、低成本和完善的高端激光加工解决方案。